

# 有機 EL 用封止フィルムの設計指針と開発動向 粘土を用いたバリアフィルムの開発

**講師： 蛭名 武雄 氏**

(国立研究開発法人産業技術総合研究所 化学プロセス研究部門 首席研究員)

有機ELの基板・封止材料については、従来のプラスチック材料では実現が不可能であったレベルの高い耐熱性や水蒸気バリア性が要求される。それらの要求特性をどのような材料設計で可能にできるか、現状の検討事例を多く取り入れながら分かりやすく解説する。また、産総研で開発された耐熱ガスバリア材料についてもその最新情報を解説する。

## 【講師経歴】

平成 5 年 3 月 東北大学大学院工学研究化博士後期過程修了(化学工学)  
平成 5 年 通産省工技院東北工業技術研究所研究官  
平成 22 年～26 年 コンパクト化学システム研究センター先進機能材料チーム長  
平成 25 年～26 年 コンパクト化学システム研究センター首席研究員  
平成 27 年～ 化学プロセス研究部門首席研究員

## 【活動内容】

平成 27 年 11 月～ ISO TC229 WG4 Expert  
平成 28 年 3 月～平成 29 年 9 月 ナノテクノロジー標準化国際審議委員会材料規格分科会委員  
平成 28 年 9 月～ 日本粘土学会 理事、Clay Science 編集委員長

開催日時	2017 年 1 月 12 日(木) 13:30～16:30	【会場】
受講料	42,000 円(税込) ※ 資料代含 * メルマガ登録者 39,000 円(税込) * アカデミック価格 25,000 円(税込)	ちよだプラットフォームスクウェア 503 会議室 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21

★ 2 名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合 2 人目は無料です。★【セミナー対象者】有機EL および関連材料に興味のある開発担当者 ★【セミナーで得られる知識】有機EL 用封止フィルムの設計指針・開発動向についての知識。柔軟性、耐熱性、水蒸気バリア性を併せ持つ材料についての設計方針。

## 【本セミナーのプログラム】

※適宜休憩が入ります。

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. バリアフィルムの開発動向</b><br>1-1 バリアフィルムの要求性能<br>各製品で要求されるガスバリア値<br>1-2 各社バリアフィルムの開発状況<br>バリア材の構造<br>バリア性フィルム市場<br>各種高分子フィルムのバリア性<br>各種透明蒸着フィルムのバリア性<br>多積層バリア<br>各社バリアフィルムの開発状況<br>さらなるハイバリアに向けた設計指針 | <b>2. 水蒸気バリア性の評価</b><br>2-1 フィルムの水蒸気バリア性<br>2-2 耐クラック性<br>2-3 端面封止材の水蒸気バリア性      |
|  | <b>3. 粘土膜の製造</b><br>3-1 粘土と成膜性<br>3-2 製膜プロセス<br>3-3 特性<br>3-4 応用例<br>3-5 産業化スキーム |

弊社記入欄		<b>セミナー申込書</b>	
セミナー名		<b>有機EL 用封止フィルムの設計指針と開発動向、粘土を用いたバリアフィルムの開発</b>	
所定の事項にご記入下さい メルマガ会員、 登録希望の場合は○↓		会社名(団体名)	TEL :
		住所 〒	FAX :
		E-mail :	
会員登録済み	新規登録希望	部署	役職
		氏名	
お支払方法		銀行振込・その他	お支払予定
			年 月 日頃

■申込方法：セミナー申込書にご記入の上 FAX または E-mail (re@cmcre.com) でお申し込みください。  
■申込先：(株)シーエムシー・リサーチ 東京都千代田区神田錦町 2-7 TEL03-3293-7053  
■本セミナーの関連情報は、弊社HPでもご覧になれます。⇒ <http://www.cmcre.com>

**参加申込 FAX 番号**  
**03-3291-5789**